

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-047

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	财通证券、南方基金、前海粤大、国联基金、中信证券、南方天辰、上汽投资、中邮证券、广发基金、红杉中国，共 14 人。
时间	2024 年 12 月 16 日
地点	公司会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 任怡 证券事务代表 张易弛
交流内容及具体问答记录	<p>一、回答投资者提问：</p> <p>1、请问四季度经营情况？</p> <p>回答：</p> <p>今年以来，在市场持续拓展、新产品新应用放量、市场需求增长（新产品放量，老产品提份额）等因素的综合作用下，公司产能利用率持续保持较为健康的状态。</p> <p>随着消费市场进一步回暖以及公司新产品新应用的不断拓展，产能利用率整体水平将持续保持健康水平。</p> <p>2、注意到公司车载业务的增长相比下游整车增速明显较快，请问是什么原因导致的？</p> <p>回答：</p> <p>汽车电子业务领域是公司未来发展的重要业务领域之一，公司通过提前布局该业务领域（2009年开始设想规划汽车电子业务；2017年产品通过tier1车规级认</p>

证)，成立专门事业部及下属控股子公司。

国内新能源汽车渗透率在2021-2023年提升速度较快，在车规业务布局初期，车载产品结构较为单一，同时产品占核心大客户份额较高，业务受客户备货及库存影响较大；公司持续布局车载新产品新应用（新产品需要至少提前三年开始布局），目前公司早期布局的新产品从2023年中期开始逐步放量，在今年新能源整车销量增速下降的趋势下，车载业务连创新高，2024年1-3季度同比增长90.47%。

目前，智能驾驶、BMS系统、电机电控等应用方向的新产品不断推出，国内销售占比进一步增加，产品组合复合度进一步提升，产品应用结构持续优化中。

3、请问公司陶瓷结构产品和客户推动情况？

回答：

公司布局陶瓷产品多年，下属子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司在结构陶瓷领域深耕多年，产品包括高性能陶瓷材料及制品、结构件陶瓷等，属于平台化研发、定制化产品。

目前主要应用市场为智能穿戴、消费电子、新能源、医疗等领域；陶瓷材料拥有优异的材料特性，公司积极布局新应用领域，在新能源汽车、光伏等市场项目推动进展顺利，同步投入SOFC等新兴应用市场的开拓。

4、请介绍公司的绕线产品结构和新产品？

回答：

公司为业内知名电子元器件厂商，拥有四大产品线系列——磁性器件、敏感及传感器件、微波器件、精密陶瓷，主要用于“整机的信号处理功能”及“整机的电源管理功能”等领域，是信号处理和电源管理的核心元器件。

从工艺平台上区分，可以区分为叠层工艺平台、绕线工艺平台、结构陶瓷工艺平台、薄膜工艺平台、PCB工艺平台等制造技术平台。其中绕线工艺，主要供应电源

管理大类的产品，如精密绕线功率型电感、高可靠性精密功率电感、一体成型功率电感、AI 服务器专用精密功率电感、开关电源平面变压器、开关电源变压器、通讯变压器等。

5、请问海外日系友商的报价汇率是否会对公司业务造成报价压力？

回答：

汇率波动的影响属于短期外部因素，公司产品在性能、质量、响应、交付等方面均有优势，客户会综合考量，目前客户对外币汇率短期波动带来的报价影响接受程度良好。

6、请问公司专利诉讼的进展？

回答：

公司一贯秉承“遵循标准、科技创新、持续改进，向全球客户提供优异的产品和完善的服务”的经营理念，自成立以来，一直高度重视研发、高度重视知识产权研究和布局，2024年上半年研发投入人民币2.24亿元，相比2023年上半年，增长19.91%。截至2024年6月30日，整个集团拥有已获得授权专利977项，其中发明专利367项，实用新型专利589项，外观设计专利21项。

在诉讼请求方面，公司对原告主张不予认可，目前正在准备积极应诉。公司产品系列及产品型号众多，本次专利诉讼仅涉及部分产品型号。

公司有清晰的战略规划和明确的经营目标、经营策略，不会受外部干扰。目前公司的生产经营情况一切正常。

7、请问资本开支方面的安排？

回答：

(1) 公司本身所处行业属于重资本投入行业，每年均有持续扩产需求，对资金需求较高（资本投入同时也是行业壁垒）；

(2) 公司仍处于持续成长阶段，新业务新领域的快速

	<p>发展，需要持续投入产能；</p> <p>(3) 公司十分重视研发投入(公司研发投入包括研发费用和研发设备投入)，每年均持续投入较高比例研发资金，研发支出长期看处于持续增长态势；</p> <p>(4) 近几年公司资本开支的重要组成部分为工业园基础建设投入，随着三个工业园和研发中心相继完工，未来几年以园区基建为主的投资将会明显放缓；</p> <p>(5) 关于资本市场融资方面，后续将根据公司具体投资进度来规划资金需求，制定合适的融资计划，短期内暂不考虑采取资本市场直接融资方案。</p> <p>8、请问公司钽电容产品的进展？</p> <p>回答：</p> <p>公司布局钽电容产品多年，不断投入研发力量，通过材料、工艺、制造方面深厚的积累，已经开发出全新工艺的新型结构钽电容产品，可以广泛应用于通讯、消费类电子、汽车电子、服务器、工控等领域。</p> <p>公司长期致力于新材料、新技术研究和新产品开发，在满足全球高端电子制造企业严苛的品质需求以及建立安全供应链的基础上，通过持续创新满足全球高端电子制造企业的发展需要，开拓市场应用领域，为公司稳健增速发展奠定坚实的基础。</p> <p>目前公司各类钽电容产品，为客户配套供应产品线，客户认可度高，市场及客户层面持续推动中。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露重大信息</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>